



(43) 國際公開日
2005 年 6 月 16 日 (16.06.2005)

PCT

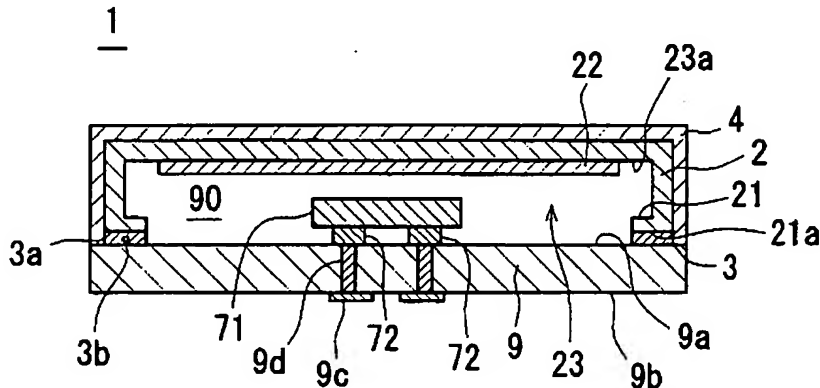
(10) 国際公開番号
WO 2005/055317 A1

- | | | | |
|---|-----------------------------|---|--|
| (51) 国際特許分類 ⁷⁾ : | H01L 23/10 | (72) 発明者; および | |
| (21) 国際出願番号: | PCT/JP2004/017931 | (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 東 和司 (HI-GASHI, Kazushi). 石谷 伸治 (ISHITANI, Shinji). | |
| (22) 国際出願日: | 2004 年12 月2 日 (02.12.2004) | (74) 代理人: 河宮 治, 外 (KAWAMIYA, Osamu et al.); 〒5400001 大阪府大阪市中央区城見 1 丁目 3 番 7 号 I M P ビル 青山特許事務所 Osaka (JP). | |
| (25) 国際出願の言語: | 日本語 | (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW. | |
| (26) 国際公開の言語: | 日本語 | (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ | |
| (30) 優先権データ: | | | |
| 特願2003-407232 | 2003 年12 月5 日 (05.12.2003) | JP | |
| 特願2003-410046 | 2003 年12 月9 日 (09.12.2003) | JP | |
| 特願 2003-420643 | 2003 年12 月18 日 (18.12.2003) | JP | |
| (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 松下電器産業株式会社 (MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD.) [JP/JP]; 〒5718501 大阪府門真市大字門真 1 0 0 6 番地 Osaka (JP). | | | |

[統葉有]

- (54) Title: PACKAGED ELECTRONIC ELEMENT AND METHOD OF PRODUCING ELECTRONIC ELEMENT PACKAGE**

- (54) 発明の名称: パッケージされた電子素子、及び電子素子パッケージの製造方法



- (57) Abstract:** A first container member (9, 109, 212) on which an electronic element (71, 171, 261) are mounted and a second container member (2, 102, 202) are joined by an adhesive agent (3) or a metallic layer (103, 251) to form an inner space (90, 190, 211), and the electronic element can be sealed in the inner space at low temperatures. When the adhesive agent is used, an exposed surface of the adhesive agent is covered with a metallic film (4) to improve sealing ability. Further, the electronic element (261, 272) can be mounted also on the second container member, and as a result an electronic element package is highly densely packaged.

- (57) 要約: 電子素子(71、171、261)を実装した第1容器部材(9、109、212)と、第2容器部材(2、102、202)とを接着剤(3、103)又は金属層(103、251)にて接合することで、内部空間(90、190、211)を形成し、低温にて上記電子素子を上記内部空間内に密閉することができる。接着剤を用いる場合には、接着剤の露出面を金属膜(4)にて覆い、上記内部空間の密閉性の向上を図る。さらに、上記第2容器部材にも電子素子(261、272)を実装することで、電子素子パッケージにおける高密度化を図ることができる。



BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

添付公開書類:

— 国際調査報告書